

2026年4月22日

メック株式会社

## 日米企業による次世代半導体パッケージ開発・コンソーシアム「US-JOINT」本格稼働

メック株式会社（代表取締役社長：前田和夫、以下、メック）は、次世代半導体パッケージ分野における新たな技術開発モデルの構築を目指し、日米の材料・装置メーカーなど12社が参画するコンソーシアム「US-JOINT」が本格稼働を開始したことをお知らせします。

始動にあたり、4月20日（現地時間）、米国・シリコンバレーの現地拠点にて、日米の政府関係者・参画企業などが出席した、オープニングセレモニーが開催されました。

なお、US-JOINTは米国初の、先端半導体パッケージに特化したコンソーシアムとなります。



「US-JOINTは、日米の参画企業12社が、ハイパースケーラーの拠点であるシリコンバレーで開発を行うことにより、コンセプト検証の期間を約6か月から、最短で1か月程度にまで短縮することを目指します。日米の半導体関連企業が“共創”することで、世界の半導体のイノベーションを加速させます。」  
（株式会社レゾナック 代表取締役社長 CEO 高橋秀仁氏）

「US-JOINTのような共創の取り組みは、まさに業界がこれまで必要としてきたものだと感じています。シリコンバレーでUS-JOINTのR&Dセンターが本格稼働することを、大変楽しみにしています。この取り組みによって半導体イノベーションが加速し、現在の延長線上にとどまらない、まったく新しいブレークスルーが生まれることを期待しています。」

（Broadcom Inc. Vice President and Head of Global IC Operations Dilip Vijay（ディリップ・ヴィジャイ）氏）

「US-JOINT がシリコンバレーを拠点に本格稼働することで、対面での技術対話が促進され、フィードバックの迅速化や認識の明確化を通じて、より効率的な共同開発が進むことを期待しています。本イニシアチブを通じて生まれるイノベーションや、エコシステム全体における協業のさらなる強化に大いに期待しています。」

(Advanced Micro Devices, Inc. Vice President of Heterogeneous Integration Technologies  
Raja Swaminathan (ラージャ・スワミナサン) 氏)

「生成 AI の急速な拡大とそれに伴う計算需要の高度化により、半導体は、先進的なパッケージング技術が求められています。この US-JOINT が、生成 AI 向けコンピューティングにおける先進パッケージングおよびチップレット技術のイノベーションの出発点になると強く確信しています。本日の取り組みに尽力されたすべての皆さまに深く感謝するとともに、この一歩が、米国と日本、そして世界にとって大きな成果となることを心より願っています。」

(経済産業省 貿易経済安全保障局 経済安全保障政策統括調整官 西川 和見氏)

生成 AI や自動運転などの成長分野では、半導体の性能向上に伴い、後工程における先端半導体パッケージ技術の重要性が一層高まっています。一方で、新しいパッケージコンセプトが次々に生まれる中、それらを迅速かつ実践的に検証できる環境が限られていることが、技術開発のボトルネックとなっていました。

US-JOINT は、シリコンバレーに開設した研究開発拠点を活用し、先端半導体の主要ユーザーである顧客とともに半導体パッケージの最新コンセプトの検証を行います。市場ニーズをリアルタイムで捉え、日米トップメーカーの材料・装置分野の技術力と、米国の半導体ユーザーや新しいアイデアが集積する環境を掛け合わせることで、材料、評価・実装技術の研究開発を加速させ、新技術の早期実用化・事業化につなげていきます。

### ■US-JOINT におけるメックの役割

当社は、半導体パッケージ基板製造プロセスにおいて、銅-樹脂層間密着工程に不可欠なソリューションを提供し世界トップシェアを有しています。創業以来培ってきた電子基板向け薬品開発の知見に加え、高い技術力、ソリューション提供力が当社の大きな強みです。

これまで磨いてきた金属表面処理と培ってきた知見を活かし、US-JOINT への参画を通じて、米国における半導体業界の技術革新と進展を加速することを目指します。さらに、高い技術力をもつ国内外の参画企業と連携し新たな価値の創出に貢献いたします。

本コンソーシアムでの活動が、次世代半導体パッケージング技術の進化を支え、デジタル社会の発展や持続可能な社会づくりにつながることを期待しています。

■US-JOINT 概要

名称	US-JOINT (JOINT : Jisso Open Innovation Network of Tops)
目的	米国における次世代半導体パッケージの評価プラットフォーム創成と実装技術の開発
参画企業 アルファベット順	12社 (2026年4月20日時点) Azimuth Industrial、KLA Corporation、Kulicke and Soffa Industries、メック株式会社、Moses Lake Industries、ナミックス株式会社、東京応化工業株式会社、TOPPAN 株式会社、TOWA 株式会社、株式会社アルバック、3M Company、株式会社レゾナック
所在地	米国カリフォルニア州 ユニオンシティ
稼働開始	2026年4月 (本格稼働)
主な設備・環境	先端半導体パッケージングプロセス (パターニング、ボンディング、モールド、めっき等)、評価・解析装置、クリーンルーム (クラス 100, 1,000)
拠点の役割	次世代半導体パッケージのコンセプト検証を行う研究開発拠点
想定利用者	ファブレス企業、半導体メーカー、参画企業の技術者



—US-JOINT ロゴ—



—US-JOINT 参画企業—

以上